声明：

本组织保证本产品描述中的产品参数及关键部件、材料等信息与实际生产的认证产品保持一致，确保认证产品持续符合认证要求。获证后，如果影响产品标准符合性的参数及关键材料发生变化，本组织将向方圆提出认证变更，经方圆确认符合认证要求后方可实施变更。

认证申请方（或生产企业）：

日期： （公章）

1. 申请认证产品信息
	1. 产品构成的描述及结构特点（结构概要说明）:

包括产品的主要组成部件,操作方式,安装方式,接线方式等，还包括以下内容：

 1).产品型号及名称，

 2).提供图纸及编号：

总装配图，

电子组件板原理图。

 3).主要结构数据：

 a.热元件

 热双金属片式：热双金属材料型号及规格，

 加热元件材料型号及规格。

 b.机构和壳体

 壳体材料名称及牌号，

 片状弹簧（或螺旋弹簧）的材料及牌号。

* 1. 主要技术参数:

1）额定绝缘电压Ui ：

2）额定冲击耐受电压Uimp：

3）额定工作电压Ue：

4）额定工作电流（整定电流范围） Ie：

5）脱扣级别：

6）额定控制电源电压（辅助工作电源电压Us）：

7）极数：

8）外壳防护等级：

9) 飞弧距离（mm）：

10）接线端子连接导线能力：

a.最大导线截面,连接至接线端子最多根数

b. 最小导线截面,连接至接线端子最多根数

c. 螺纹直径或拧紧力矩

 11）额定限制短路电流Iq：（对应于电压）：，配用SCPD型号：，协调配合类型：

12）辅助回路：种类和对数，

约定发热电流，

额定绝缘电压，

额定限制短路电流配合SCPD型号：，

相应使用类别下额定工作电流和工作电压。

* 1. 系列的描述和型号的解释:
		1. 本申请单元产品：

　a. 双金属元件材料、结构和连接方法是否相同：

□ 是 □ 否

 b. 加热元件材料、结构和连接方法是否相同：

□ 是 □ 否

c. 弹簧是否相同：

 □ 是 □ 否

d. 电子组件板是否相同（如有）：

 □ 是 □ 否

e. 模压和绝缘材料是否相同：

 □ 是 □ 否

f. 接线端子是否具有类似的结构：

 □ 是 □ 否

* + 1. 系列的描述（对本申请单元不同型号、不同电流等级的异同说明）：
		2. 型号的解释：
	1. 特殊结构说明（如有需要）:
	2. 产品认证情况:
	3. 安全件一览表:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元/部件名称 | 元件/材料名称 | 型号规格/牌号 | 制造商（生产厂） |
| 1 | 壳体 |  |  |  |
| 2 | 触头 |  |  |  |
| 3 | 双金属元件 |  |  |  |
| 4 | 加热元件 |  |  |  |
| 5 | 互感器 |  |  |  |
| 6 | 微处理器 |  |  |  |
| 7 | 电子组件板 |  |  |  |

注1：安全件如涉及一个以上的制造商（生产厂），则填在第一位的制造商（生产厂）为型式试验样品提供安全件的制造商（生产厂）。

注2：本企业声明：安全件如涉及一个以上的制造商（生产厂），型式试验样品所选用制造商（生产厂）提供的安全件与本企业所填写的其他制造商（生产厂）提供的该安全件不存在性能上的差异。

1. 检验样品信息(适用于企业送样)
	1. 样品名称： 规格型号： 生产序号：
	2. 样品的参数描述：
	3. 关键元器件、零部件、原材料

注：根据认证规则中的样品要求，认证申请方填写符合检验要求的样品信息。

1. 图纸照片（以电子图片方式附后）
	1. 图纸：产品结构/装配图纸、电气原理图
	2. 照片：外观、包装、铭牌、标签照片
	3. 工艺配方、材料组成、工艺流程（图）

注：根据产品种类及认证特性，选定“图纸照片”的类型并明确填报要求。

1. 检验报告
	1. 认证产品检验报告：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 报告编号 | 报告时间 | 检验试验室 | 样品名称、规格型号 | 检验依据标准 | 检验项目 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* 1. 关键元器件、零部件、原材料检验报告：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件名称 | 报告编号 | 报告时间 | 检验试验室 | 样品名称、规格型号 | 检验依据标准 | 检验项目 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：表中报告扫描电子版附后。